

Title (en)

Circuit board for high currents and process of making the same.

Title (de)

Leiterplatten für hohe Ströme und Verfahren zur Herstellung.

Title (fr)

Plaque circuit pour courants élevés et procédé de préparation.

Publication

**EP 0312415 A1 19890419 (FR)**

Application

**EP 88402418 A 19880926**

Priority

FR 8714039 A 19871012

Abstract (en)

The circuit board is of the type comprising a metal sheet (1) in which separate tracks (2) forming at least one electrical circuit are cut out, holes (18), some of which are provided for the passage of the components to be connected to the said tracks, and a layer of insulation (19) disposed over at least one face of the said metal sheet. The board is characterised in that at least one part of the attachments (4) connecting the tracks (2) are bent over one of their ends towards the face (11) covered with insulation (19) and in that the said attachments are embedded in the insulation for their major part which is folded over. Application especially to the production of high-density electrical circuits for interconnection modules, for example. <IMAGE>

Abstract (fr)

Elle est du type comprenant une feuille métallique (1) dans laquelle sont découpées des pistes (2) séparées constituant au moins un circuit électrique, des orifices (18) dont certains sont ménagés pour le passage des composants à connecter auxdites pistes, une couche d'isolant (19) disposée sur au moins une face de ladite feuille métallique et elle est caractérisée en ce qu'au moins une partie des rattaches (4) reliant les pistes (2) sont repliées autour d'une de leurs extrémités vers la face (11) recouverte d'isolant (19), et en ce que lesdites rattaches sont dans leur majeure partie qui est repliée, noyées dans de l'isolant. Application notamment à la réalisation de circuits électriques haute densité pour boîtiers d'interconnexion par exemple.

IPC 1-7

**H05K 3/04**; **H05K 3/20**

IPC 8 full level

**H05K 3/20** (2006.01); **H05K 3/38** (2006.01); **H05K 1/00** (2006.01); **H05K 3/00** (2006.01); **H05K 3/40** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H05K 3/202** (2013.01); **H05K 3/38** (2013.01); **H05K 1/0298** (2013.01); **H05K 1/0393** (2013.01); **H05K 3/0014** (2013.01); **H05K 3/4084** (2013.01); **H05K 3/4092** (2013.01); **H05K 2201/0382** (2013.01); **H05K 2201/0394** (2013.01); **H05K 2201/09118** (2013.01); **H05K 2201/2072** (2013.01); **H05K 2203/175** (2013.01); **H05K 2203/302** (2013.01)

Citation (search report)

- [AD] FR 2531597 A1 19840210 - DAV IND [FR]
- [A] FR 2345888 A1 19771021 - WESTFAELISCHE METALL INDUSTRIE [DE]
- [A] DE 2536029 A1 19770224 - WESTFAELISCHE METALL INDUSTRIE
- [A] FR 2344151 A1 19771007 - AMP INC [FR]
- [A] DE 1237191 B 19670323 - TELEFONBAU, et al
- [A] FR 2272573 A1 19751219 - EBAUCHES SA [CH]

Cited by

FR2697715A1; EP0891124A3; US5831835A; EP2739127A3; US5847937A; FR2752913A1; EP0634888A1; US5446626A; EP1014764A1; US6423910B1; US6165595A; GB2243479B; EP0835046A4; EP1940206A3; EP0776538A4; US6496377B1; US8068348B2; US9874335B2; WO2007093294A3; WO9607302A1; WO9608023A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0312415 A1 19890419**; **EP 0312415 B1 19930407**; DE 3880067 D1 19930513; DE 3880067 T2 19931007; ES 2039670 T3 19931001; FR 2621774 A1 19890414; FR 2621774 B1 19900216

DOCDB simple family (application)

**EP 88402418 A 19880926**; DE 3880067 T 19880926; ES 88402418 T 19880926; FR 8714039 A 19871012